

Pressemitteilung

Siltronic AG
Einsteinstraße 172
81677 München
www.siltronic.com

Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 1,20 je Aktie

München, 13. Mai 2024 – Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Siltronic AG am heutigen Tag blicken Vorstand und Aufsichtsrat auf ein herausforderndes Geschäftsjahr 2023 zurück. Die anhaltende Nachfrageschwäche, vor allem bedingt durch erhöhte Lagerbestände und die damit einhergehenden Verschiebungen von Liefermengen wird auch das laufende Geschäftsjahr beeinflussen.

Angesichts dieser erwarteten Entwicklung für das Geschäftsjahr 2024, hat der Vorstand der Hauptversammlung vorgeschlagen, eine Dividende von EUR 1,20 für das abgelaufene Geschäftsjahr auszuschütten. Die Aktionärinnen und Aktionäre sind dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat gefolgt. Damit fließen insgesamt EUR 36 Mio. an die Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von knapp 20 Prozent des auf Siltronic-Aktionäre entfallenden Konzerngewinns. Eine generelle Änderung der Dividendenpolitik ist dabei nicht vorgesehen.

Alle Tagesordnungspunkte wurden von den Aktionären mit großer Mehrheit angenommen. Insgesamt waren 64,10 Prozent des Grundkapitals der Siltronic AG auf der Hauptversammlung vertreten.

Die Hauptversammlung der Siltronic AG fand in Präsenz statt. Die Reden des Vorstandsvorsitzenden und des künftigen Chief Operating Officer (COO) wurden live auf der Website übertragen und sind auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht.

In seiner Rede ging Vorstandschef Dr. Michael Heckmeier auf das Geschäftsjahr 2023 und die zukünftige Entwicklung der Siltronic ein. „Nach einem herausfordernden Geschäftsjahr 2023 gehen wir davon aus, dass 2024, geprägt von der anhaltenden Nachfrageschwäche, ein Übergangsjahr zu einem profitablen Wachstum werden wird. Getrieben von Megatrends wie künstlicher Intelligenz, Elektromobilität und Digitalisierung erwarten wir mittel- und langfristig eine deutlich steigende Nachfrage. Dank unserer neuen Fabrik in Singapur, der globalen Präsenz und der hohen Innovationskraft sind wir für dieses Wachstum bestens positioniert“, sagte Heckmeier.

Im Rahmen einer kurzen Rede stellte sich Klaus Buchwald der Hauptversammlung vor. Er wird zum 1. Juni 2024 seine Tätigkeit als neues Vorstandsmitglied und COO der Siltronic AG aufnehmen und für die Bereiche Operations und Supply Chain, Engineering sowie IT verantwortlich sein.

„Wir freuen uns schon darauf, Herrn Buchwald im Vorstand der Siltronic AG begrüßen zu dürfen. Mit seiner umfassenden Expertise und seinem tiefgreifenden Verständnis der Halbleiterindustrie wird er gemeinsam mit Herrn Heckmeier und Frau Schmitt zur Verwirklichung unserer Ambitionen und zum weiteren profitablen Wachstum von Siltronic beitragen“, so Dr. Tobias Ohler, Aufsichtsratsvorsitzender der Siltronic AG.

Die Unterlagen und Abstimmungsergebnisse zur Hauptversammlung sind unter <https://www.siltronic.com/de/investoren/hauptversammlung.html> verfügbar.

**Kontakt:**

Verena Stütze

Leiterin Investor Relations & Communications

Tel.: +49 (0)89 8564 3133

E-Mail: investor.relations@siltronic.com

Unternehmensprofil:

Als einer der führenden Waferhersteller ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik – von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten.